

半导体新闻周报

汇报时间：2025.11.14

目录

一. 长鸿高科1亿元投资加码存储芯片.....	3
二. 政策加码，河北聚焦碳化硅、氮化镓等领域.....	6
三. 台积电2nm加持，AMD Instinct MI400与Zen 6架构EPYC效能大增.....	7
四. 半导体迎新一轮扩产潮？晶圆代工、封装、光刻胶风云涌动.....	9
五. 上海市杨浦区政府与新思科技签订战略合作.....	11
六. 格罗方德与台积电签署引进氮化镓生产技术授权协议.....	13
七. 95亿美元，伊顿收购宝德，布局数据中心液冷技术.....	15
八. 软银以58亿美元出售英伟达股份，重心转向OpenAI投资.....	18
九. SK keyfoundry计划明年上半年启动碳化硅功率半导体代工业务.....	21
一〇. AMD CEO苏姿丰：2030年AI数据中心市场将超1万亿美元.....	23

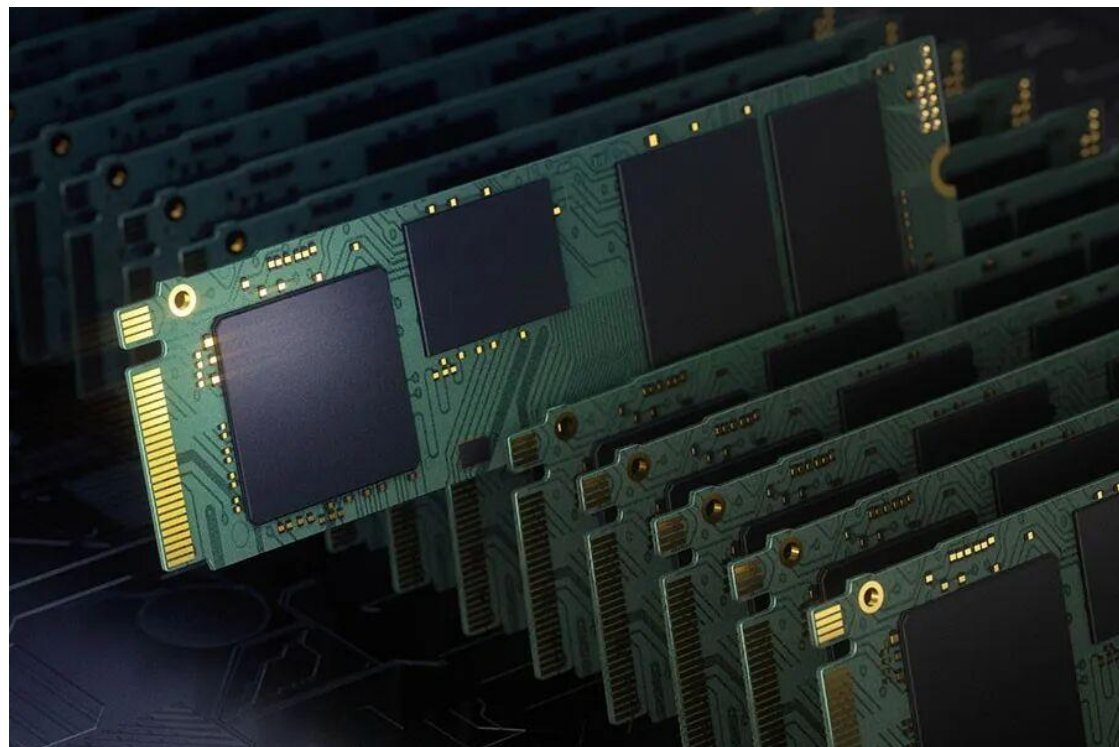
①长鸿高科1亿元投资加码存储芯片

2025. 11. 10

11月7日，**长鸿高科**与**新存科技（武汉）有限责任公司**（以下简称“新存科技”）签署“增资认购协议”，长鸿高科拟出资1亿元人民币认购其部分股份。

长鸿高科是国内苯乙烯类热塑性弹性体（TPES）的研发与生产领军企业，产能稳居全国前三。为响应“双碳”目标，公司战略性地切入全生物降解塑料赛道，投资建设规模位居全国前列的PBAT/PBS/PBT产业园，并已完成上游碳酸钙母链的产业一体化布局。

新存科技由长江存储孵化，聚焦三维相变存储PCM芯片设计、研发与制造，致力于推动国产高性能存储器产业化，目前天山电子合计持股2%。



- 宁波长鸿高分子科技股份有限公司
- 成立时间：2012年6月15日
- 地点：浙江省宁波市北仑区戚家山港口路108号
- 官网：<http://www.changhongpolymer.com.cn/>

宁波定鸿创业投资合伙企业	流通A股	425,490,094	65.87%
深圳君盛峰石股权投资基金合伙企业	流通A股	89,902,071	13.92%
陶春风	流通A股	17,582,000	2.72%
上海思德投资管理有限公司	流通A股	10,194,210	1.58%
张婷玲	流通A股	5,130,125	0.79%
张君飞	流通A股	2,672,300	0.41%
徐晓芳	流通A股	2,460,540	0.38%
江西鸿伟钢结构工程有限公司	流通A股	2,267,300	0.35%
钱武鹏	流通A股	1,945,500	0.30%
侯凤玉	流通A股	1,672,480	0.26%



补充信息—新存科技（武汉）有限责任公司

- 新存科技（武汉）有限责任公司
- 成立时间：2022年7月29日
- 地点：武汉东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城
龙山创新园一期B4栋18楼534（自贸区武汉片区）

● 股东信息：

上海昊元古信信息管理合伙企业	24.84319%，443.6383 万
武汉市科铭芯企业管理合伙企业	22.3995%，400 万
安吉高维安芯科技合伙企业	16.79963%，300 万
上海科语宸企业管理合伙企业	11.13044%，198.7622 万
刘峻	6.99984%，125 万
鞠韶复	6.99984%，125 万
武汉市科凌芯企业管理合伙企业	2.79994%，50 万
武汉鼎典私募股权投资基金合伙企业	2.6087%，46.5849 万
嘉兴德宁昊坤股权投资合伙企业	2.2029%，39.3383 万
上海泰龙芯信息合伙企业	1.15943%，20.7045 万



②政策加码，河北聚焦碳化硅、氮化镓等领域

2025. 11. 10

近期，河北省工业和信息化厅发布《关于2025年第三代半导体、新型显示产业拟支持项目的公示》，重点聚焦碳化硅（SiC）、氮化镓（GaN）等高端材料领域，通过财政补贴、产能扶持与产学研协同等方式，推动国内第三代半导体产业发展。

河北同光半导体股份有限公司：主要从事碳化硅单晶的研发、生产和销售，是国内较早从事第三代半导体碳化硅衬底研发与生产的企业之一。作为河北省重点扶持的第三代半导体企业，同光半导体专注于碳化硅（SiC）单晶衬底研发与生产，产品广泛应用于新能源车、5G通信、智能电网等领域。同时，该公司依托中科院技术团队，突破国外技术垄断，已建成国内领先的SiC量产线，客户覆盖头部企业，助力中国半导体产业链自主可控。

河北普兴电子科技股份有限公司：致力于半导体材料的外延业务，在碳化硅外延片等方面有相关技术和产品，为碳化硅器件制造提供关键材料。

中国电子科技集团公司第十三研究所：在半导体领域有广泛研究，在氮化镓等第三代半导体材料和器件的研发与生产方面具有深厚的技术积累和产业基础。

2025年第三代半导体、新型显示产业拟支持项目

序号	企业名称	项目类别
1	河北博威集成电路有限公司	首次工程流片
2	石家庄钨依电子科技有限公司	首次工程流片
3	河北省青孚数字科技有限公司	购买国产 IP 核、EDA 软件
4	河北博威集成电路有限公司	购买国产 IP 核、EDA 软件
5	河北同光半导体股份有限公司	产业链配套
	河北普兴电子科技股份有限公司	
6	武安市翅楚气体有限公司	产业链配套
	河北邯钢特种气体有限公司	
7	河北普兴电子科技股份有限公司	产业链配套
	中国电子科技集团公司第十三研究所	
8	唐山三孚电子材料有限公司	产业链配套
	河北普兴电子科技股份有限公司	
9	凌度电子科技（固安）有限公司	产业链配套
	固安翌光科技有限公司	
10	稻丰智谷（固安）电子有限公司	产业链配套
	维信诺（固安）显示科技有限公司	
11	海鑫一造集成电路（廊坊）有限公司	产业链配套
	固安翌光科技有限公司	
12	河北凡克新材料有限公司	产业链配套
	石家庄诚志永华显示材料有限公司	
13	石家庄市凯信电子材料有限公司	产业链配套
	石家庄诚志永华显示材料有限公司	
14	固安鼎材科技有限公司	产业链配套
	云谷（固安）科技有限公司	

③台积电2nm加持，AMD Instinct MI400与Zen 6架构EPYC效能大增

2025.11.10

芯片大厂**AMD**日前公布2025年第三季财报时，不仅交出亮眼的营收成绩单，更由执行长苏姿丰亲自证实，其采用最先进制程技术的下一代数据中心旗舰芯片——2纳米制程的EPYC Venice Zen 6 CPU与Instinct MI400 AI芯片，正按计划进行，将如期在2026年正式发布。

苏姿丰在财报会议中重申，下一代EPYC Venice系列处理器将采用台积电2纳米制程技术，并搭载Zen 6架构。她确认，Venice芯片目前已进入实验室阶段，表现极佳。相较于前一代的Zen 5架构的Turin CPU，Venice在性能、效率与运算密度上达到了实质性的成长。

AMD表示，客户对于Venice系列处理器的采购意愿和参与度是公司前所未见的强劲，反映了其竞争优势以及市场对数据中心运算需求的成长。更值得注意的是，多家云端OEM合作伙伴已经将首批Venice平台上线测试，为该产品在2026年推出时达成广泛的解决方案可用性和云端部署做好准备。



- 超威半导体公司 Advanced Micro Devices, Inc. (AMD)
- 成立时间：1969年5月1日
- 地点：美国加利福尼亚州圣克拉拉市
- 官网：<https://www.amd.com/zh-cn.html>
- 公司致力于开发设计集成电路产品，主要产品包括中央处理器、图形处理器、主板芯片组等，为游戏、人工智能、云计算等领域提供计算解决方案。
- AMD多次上榜全球企业2000强、美国500强，曾获欧洲硬件大奖的多个奖项，名下产品FX-8150在2011年创下“最快计算机处理器”的吉尼斯世界记录。2025年6月13日，据IT之家消息，AMD Instinct MI350 系列 GPU 发布。



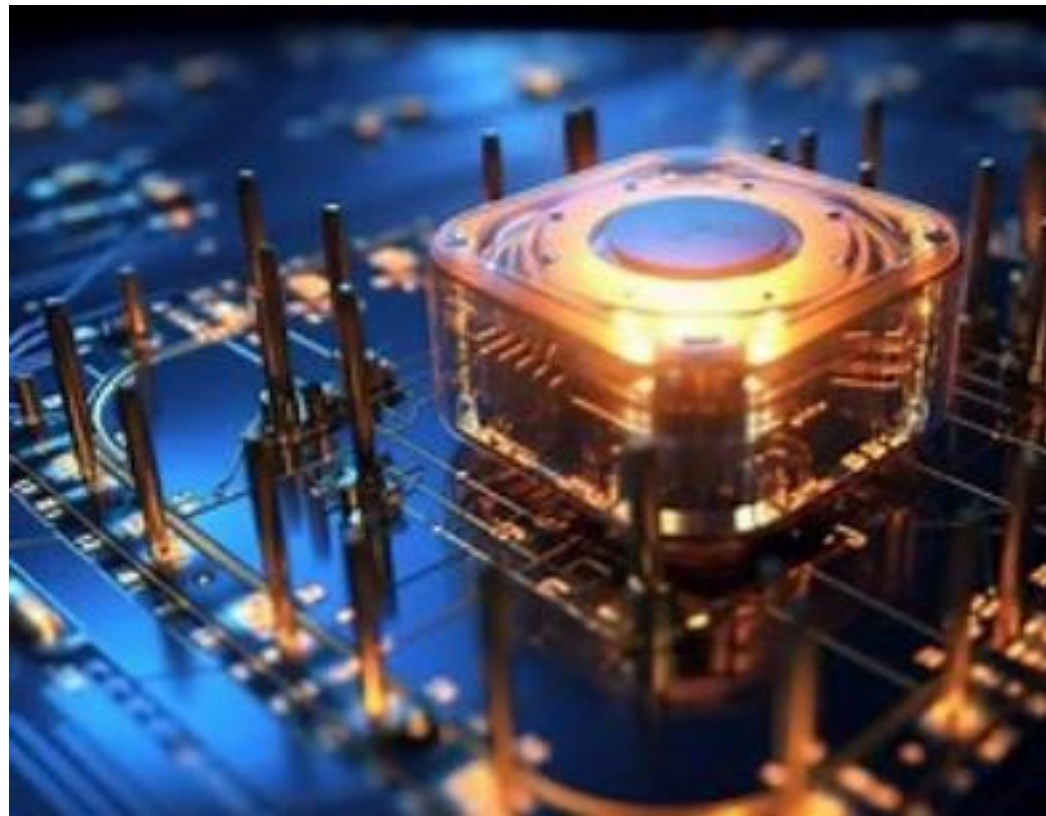
④半导体迎新一轮扩产潮？晶圆代工、封装、光刻胶风云涌动

2025. 11. 10

AI人工智能对芯片性能与产量需求呈指数级增长，半导体产业正经历着前所未有的激烈竞争与变革。近期，行业内扩产动作频发，三星德州泰勒市工厂在多方助力下加速兴建，与**特斯拉**达成重要芯片订单合作；德州仪器马来西亚马六甲新封装测试厂投入使用，强化全球供应链布局；日本芯片材料厂商也纷纷加大投资，新建光刻胶工厂或扩产，一场半导体产业的“扩产大战”已然打响。

外媒报道光刻机大厂ASML正在组建一个团队，旨在帮助三星在美国泰勒市工厂安装设备，以支持EUV光刻机之后的启动与运作，该公司目前正在招聘相关的工程师。

德州仪器宣布，在马来西亚马六甲的第二座封装和测试工厂TIEM2开始投入使用，预计未来每年将封装和测试数十亿颗芯片，加强其全球供应链布局。



- 特斯拉
- Tesla Inc.
- 成立时间：2003年7月1日
- 地点：美国德克萨斯州奥斯汀市特斯拉路1号
- 官网：<https://www.tesla.cn/>
- 特斯拉（Tesla）是一家电动汽车及清洁能源行业跨国公司，总部位于美国得克萨斯州，产销电动汽车、太阳能板、及储能设备与系统解决方案。
- 2004年，埃隆·马斯克进入公司并领导了A轮融资。2010年6月，特斯拉登陆纳斯达克，成为仅有的一家在美国上市的纯电动汽车独立制造商。2017年2月，特斯拉汽车正式更名为特斯拉，截止目前，特斯拉是全球市值最高的车企。



⑤上海市杨浦区政府与新思科技签订战略合作

2025. 11. 10

11月7日，上海市杨浦区人民政府与**新思科技**举行了战略合作签约仪式。

此次签约标志着双方合作进入新阶段，展现新思科技进入中国三十年来持续扎根市场、深耕杨浦、助力高质量发展的决心。

双方约定，未来，新思科技将继续以杨浦为基地，依托区域科教与产业优势，增强研发与客户支持能力，拓展企业社会责任，赋能客户与生态伙伴，共同探索高质量发展新路径。

薛侃在签约仪式上对双方深化战略合作表示祝贺，并向新思科技长期以来对杨浦发展的支持表示感谢。他指出，新思科技作为全球芯片产业的领军企业，始终积极布局中国市场、深耕上海、落子杨浦，其发展战略与杨浦国家创新型示范城区建设的目标高度契合，是外资企业融入中国产业生态的典范。

资料显示，新思科技（Synopsys, Inc.）成立于 1986 年，总部位于美国硅谷，是全球半导体产业的核心技术驱动者，专注于为芯片到软件的全链条提供创新解决方案。作为行业领军企业，其业务覆盖电子设计自动化（EDA）、半导体知识产权（IP）、软件安全与质量三大核心领域。



- 新思科技股份有限公司 (Synopsys Inc.)
- 成立时间：1986年
- 地点：美国加州森尼韦尔
- 官网：<https://www.synopsys.com/zh-cn.html>
- 新思科技股份有限公司（英语：Synopsys Inc.）是一家总部位于加州森尼韦尔的美国电子设计自动化（EDA）公司，专注于硅晶设计与验证、硅晶知识产权，以及软件安全与品质。Synopsys（新思科技）提供各式工具与服务给半导体设计与制造产业。其产品涵盖用于逻辑合成与集成电路实体设计的工具、开发用的模拟器，以及协助芯片与电脑系统逻辑设计的除错环境等。

SYNOPSYS® · 新思

⑥ 格罗方德与台积电签署引进氮化镓生产技术授权协议

2025.11.11

晶圆代工大厂**格罗方德（GlobalFoundries）**日前宣布与台积电签署一项技术授权协议，将引进其650V 和80V 氮化镓（GaN）技术，借以强化格罗方德在电源应用领域的布局，特别锁定资料中心、工业以及汽车等高功率市场。

格罗方德表示，计划将这项获得授权的GaN 技术，在其专门处理高压GaN-on-Silicon 技术的美国佛蒙特州伯灵顿（Burlington, Vermont）的晶圆厂进行验证。另外，根据规划，相关技术的开发工作预计将于2026 年初启动，并预计在2026 年下半年开始投产。格罗方德对此强调，这项授权协议将能加速其为客户量产下一代电源装置的能力，并在美国本土制造。



- 格芯（又译格罗方德；英语：GlobalFoundries Inc.，简称GF或GloFo）
- 成立时间：2009年3月2日
- 地点： 美国纽约马耳他（纽约州）
- 官网：<https://gf.com/zh/>
- 格芯（又译格罗方德；英语：GlobalFoundries Inc.，简称GF或GloFo）是一家总部位于美国加利福尼亚州圣克拉拉的半导体晶圆代工公司。该公司最初从超微半导体的制造部门独立而出，目前为世界第五大专业晶圆代工厂，仅次于台积电、三星电子、中芯国际及联电。2021年10月28日，公司在纳斯达克综合指数上市。该公司生产晶圆上的集成电路，主要面向智能移动设备、汽车、航空航天和国防、消费者物联网（IoT）以及数据中心和通信基础设施等市场。



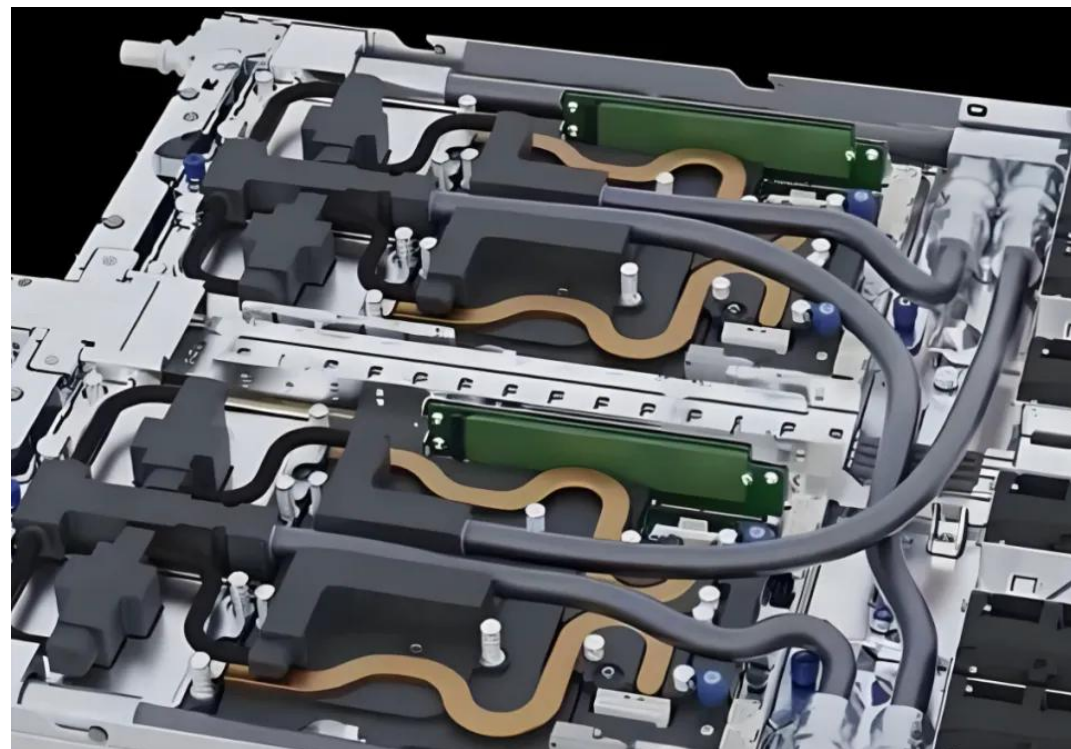
⑦95亿美元，伊顿收购宝德，布局数据中心液冷技术

2025.11.11

近日，伊顿公司（Eaton Corp.）宣布，以约95亿美元的价格收购博伊德公司（Boyd Corporation）旗下的热管理业务Boyd Thermal，交易预计在2026年第二季度完成。

资料显示，Boyd Thermal专注于液冷散热技术，主要产品包括液冷板、机架歧管、冷却剂分配装置（CDU）以及泄漏检测器等，已为数据中心、航空航天等高功率密集行业提供无泄漏的高可靠性散热方案，并且是英伟达（NVIDIA）AI服务器（如GB200、GB300）液冷板的主要供应商，同时为北美四大云服务提供商提供关键散热系统。

伊顿是一家全球领先的智能动力管理公司，近年来在数据中心领域已有扎实布局。伊顿强调，AI时代的数据中心“必须同时满足稳定性和可持续性”。该公司提供“一站式电力解决方案”战略，整合包括UPS、配电板、变压器、冷却设备和监控系统在内的整个电力基础设施。



- 伊顿公司
- Eaton Corporation
- 成立时间：1911年
- 地点：Eaton House 30 Pembroke Road Dublin 4 爱尔兰
- 官网：<https://www.eaton.com.cn/cn/zh-cn.html>
- Eaton Corporation (伊顿公司) 是一家智慧电源管理公司。提供的解决方案可帮助其客户管理电气和机械动力，包括电气产品，电气系统和服务，航太和车辆。电气产品部门包括电气组件，工业组件，住宅产品，单相电力品质，火灾探测，布线设备，结构支撑系统和电路保护。航太部门是商业和军事用途的航空燃料，液压系统和气动系统的供应商。车辆部门提供汽车，轻型卡车和商用车的传动系统，动力总成系统和关键零部件的设计，制造，销售和供应。



- 博伊德公司
- Boyd Corporation
- 地点: 5960 Inglewood Dr. Suite 115, US, CA, Pleasanton, 94588
- 官网: <https://cn.boydcorp.com/>
- 宝德 (BOYD) 公司拥有超过90年以客户为中心的成功绩效, 并且是热管理和环境密封领域的市场领导者。 专注于解决客户挑战, 在橡胶, 塑料, 金属, 灵活的环保密封和能源管理解决方案的材料科学方面拥有丰富专业知识。 经验丰富的全球团队专注于定制制造解决方案的开发以及遍布各种终端市场的世界级供应链。 提供广泛的产品系列包括可以在环境密封件和垫圈, 挤出橡胶和塑料, 模制橡胶和塑料, EMI屏蔽, 隔热等领域。



⑧软银以58亿美元出售英伟达股份，重心转向OpenAI投资

2025. 11. 12

软银集团近日宣布，已以约58亿美元的价格出售其持有的全部英伟达股份，出售股票数量达到3210万股。软银表示，此次出售并非因英伟达表现不佳，而是为了筹集资金，加大对人工智能领域，尤其是**OpenAI**的重大投资。软银首席财务官后藤义光指出，这次股票出售属于融资措施，旨在支持软银未来对OpenAI的投资需求，预计未来一年内相关投资将超过300亿美元。

此次出售标志着软银第二次完全退出英伟达股份。早在2019年，软银曾以约36亿美元的价格出售过英伟达股份，随后于2020年重新买入。此次退出反映了软银资金重心向更加看好的AI项目，尤其是OpenAI转移。

在宣布售股当天，英伟达也发布了其2025年全年销售额预期，预计区间为505亿至515亿美元，低于市场预期，导致其股价在盘前交易中下跌超过8%。这为软银出售股份提供了市场背景。

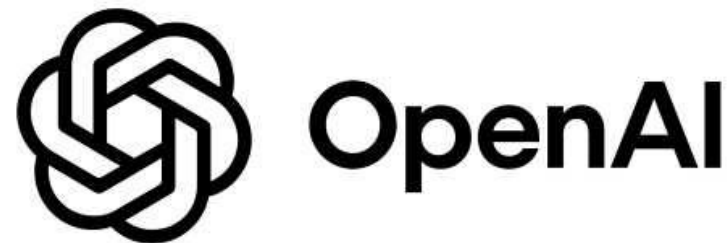


- 软件银行集团 SoftBank Group
- 成立时间：1981年9月3日
- 地点：日本东京都港区海岸1-7-1
- 官网：<https://www.softbank.jp/>

- 软件银行集团（SoftBank Group），简称软银集团，1981年9月3日由孙正义在日本东京都港区海岸1-7-1成立，是综合性风险投资公司，主营业务涵盖移动通信、固网电信及ISP服务，总部位于东京都港区，旗下拥有软银愿景基金、ARM等子公司，员工超6.5万人。



- 美国开放人工智能研究中心
- OpenAI
- 成立时间：2015年12月11日
- 地点：美国旧金山
- 官网：<https://openai.com/zh-Hans-CN/>
- OpenAI，是一家开放人工智能研究和部署公司，其使命是确保通用人工智能造福全人类。创立于2015年12月，总部位于美国旧金山。现由营利性公司OpenAI LP及非营利性母公司OpenAI Inc组成。



⑨SK keyfoundry计划明年上半年启动碳化硅功率半导体代工业务

2025. 11. 12

11月12日，韩国8英寸纯晶圆代工厂**SK keyfoundry**宣布，正加速开发碳化硅（SiC）化合物功率半导体技术。该公司近期已完成对碳化硅领域关键企业SK powertech的收购。SK keyfoundry表示，正加速推进技术开发，目标在2025年底前推出碳化硅MOSFET1200V工艺技术，并于2026年上半年启动碳化硅功率半导体代工业务。

资料显示，SK keyfoundry总部位于韩国清州。其拥有一座晶圆厂，月产能约为10万片晶圆。主要从事模拟混合信号芯片的代工业务，产品包括显示驱动芯片（DDI）、微控制器（MCU）和8英寸功率分立器件等，适用于小批量多样化产品生产。



- SK启方半导体 (SK keyfoundry)
 - 成立时间：1979年
 - 地点：忠清北道清州市兴德区大新路215号
 - 官网：<https://www.skkeyfoundry.com/cn/>
-
- SK启方半导体总部位于清州，拥有一家月产能约10万片的晶圆厂，负责开展代工业务，主要生产模拟混合信号芯片，包括显示驱动芯片、微控制器和8英寸功率分立器件，适用于小批量多样化产品生产。



⑩AMD CEO苏姿丰：2030年AI数据中心市场将超1万亿美元

2025. 11. 12

2025年11月11日的公司金融分析师日活动上，AMD首席执行官苏姿丰（Lisa Su）对人工智能（AI）市场的前景表示乐观，预计到2030年，AI数据中心的市场规模将突破1万亿美元，年复合增长率（CAGR）将超过40%。这一预测显著高于2025年约2000亿美元的市场规模。

苏姿丰指出，AI基础设施的需求将持续增长，客户的投资并未趋于平稳，反而显示出强劲的增长势头。她强调，AI和GPU的增长并未减少对CPU的需求，反而在增加。她提到，AI的工作负载正在从训练转向推理，AI加速器的市场正在以超过60%的CAGR增长，推理芯片的市场预计将更快增长。

在最新的财报中，AMD公布了第三季度营收同比增长36%，达到92.46亿美元，数据中心业务收入同比增长22%，达到43亿美元。尽管四季度的营收指引高于分析师预期，但仍低于一些乐观预期，显示出市场对AMD未来增长的期待仍然较高。苏姿丰在电话会议上首次明确了公司的长期AI收入目标，预计到2027年，数据中心AI业务年收入将达到“数百亿美元”的规模。



Thank you

🏠 江苏省南京市江宁区双龙大道1698号景枫中心写字楼26楼01室(江宁开发区)

📞 TEL:025-84148808 (09:00-17:30)

✉ E-Mail:info@bosikst.com

@ URL:https://www.bosikst.com